

Medieninformation

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Ihr Ansprechpartner

Falk Lange

Durchwahl

Telefon +49 351 564 60200

falk.lange@smwk.sachsen.de*

21.09.2016

Wissenschaftsministerin Dr. Eva-Maria Stange nahm heute symbolisch neue Anlage in Betrieb

Fraunhofer IPMS stellt Anlagen und Prozesse auf größeres Waferformat um - Freistaat Sachsen stellt 24 Millionen Euro bereit

Im Rahmen einer feierlichen Auftaktveranstaltung hat das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS heute im Beisein von Sachsens Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Dr. Eva-Maria Stange, und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert gemeinsam mit Gästen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik die Erweiterung seines Mikrosystemreinraums auf eine 200-mm-Prozesslinie offiziell gestartet. Mit der Erweiterung kann das Institut zukünftig neben Wafern mit einem Durchmesser von 150 mm auch die in der Mikrosystemtechnik industrieüblichen 200-mm-Wafer verarbeiten.

Wissenschaftsministerin Dr. Eva-Maria Stange nahm symbolisch eine der ersten neu installierten Anlagen in Betrieb und wünschte dem Fraunhofer-IPMS und seinen Partnern viel Erfolg. Dr. Stange: „Das Fraunhofer-IPMS gehört mit seinem hoch motivierten und engagierten Team weltweit zu den Wegbereitern der Erforschung und Entwicklung neuartiger hochintegrierter funktionaler Mikrosysteme. Der Freistaat Sachsen unterstützt die 200-mm-Erweiterung mit 24 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus Landesmitteln. Das Geld ist gut angelegt, denn mit diesen Mitteln wird das Fraunhofer IPMS seine zukunftsweisende Forschung mit Erfolg fortsetzen und seine Position als Pionier und Innovationsführer behaupten können.“

Die Institutsleiter des Fraunhofer IPMS, Prof. Hubert Lakner und Prof. Harald Schenk sehen in der Erweiterung auf das 200-mm-Waferformat eine Grundvoraussetzung dafür, weiterhin auf Spitzenniveau mit Partnern aus Industrie und Wirtschaft zusammenzuarbeiten. „Unsere wichtigsten Forschungs- und Entwicklungspartner sind bereits auf die 200-mm-Technologie umgestiegen“, betonte Harald Schenk. „Wir danken dem Land,

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

Bund und der EU für die Unterstützung von insgesamt 30 Millionen Euro, denn die 200-mm-Erweiterung unserer Prozesslinie setzt uns die in Lage, weiterhin mit unseren Industriepartnern technologisch kompatibel zu sein und so eine weitere Miniaturisierung und Funktionsintegration zu erreichen und Lösungen im Bereich der Mikrosystemtechnik mit unseren Partnern in die Anwendung zu bringen.“

Auch für die Industrie ist die Umstellung ein notwendiger Schritt wie Dr. Jens Kosch, CTO der X-FAB Semiconductor Foundries AG in seinem Vortrag erläuterte: „Das Fraunhofer IPMS ist ein wichtiger Entwicklungspartner für X-FAB. Durch die Angleichung des Waferformats eröffnen sich für uns neue Möglichkeiten der Arbeitsteilung in der Waferverarbeitung, so wie wir sie im gemeinsamen ECSEL-geförderten Projekt ADMONT bereits begonnen haben.“

Die Erweiterung der Anlagen und Prozesse am Fraunhofer IPMS fügt sich ein in eine Reihe von Maßnahmen der Sächsischen Landesregierung zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft mit dem Ziel, den Mikroelektronikstandort Sachsen zu stärken. So unterstützt der Freistaat Sachsen das Fraunhofer-Leistungszentrum „Funktionsintegration für die Mikro- und Nanoelektronik“ mit dem Fraunhofer IPMS als Koordinator und einer der Hauptakteure im Zeitraum 2015-2017 mit insgesamt 5 Mio. €.

Mit der 200-mm-Erweiterung werden sowohl die bestehende Versorgungsinfrastruktur angepasst als auch Anlagen und Prozesse umgerüstet und Anlagen neu beschafft. Das Gesamtvorhaben wird nach Aussage des Fraunhofer IPMS noch bis zum Jahr 2018 andauern